

高可靠硅脂 RH-TSG-14

特色:

- 有机硅导热复合物
- 膏状
- 耐高温，无小分子释放
- 高热稳定性，耐热冲击循环

产品组成

- 硅油
- 无机导热填料

产品应用

- CPU、IGBT 等半导体散热
- 汽车电子设备
- LED 照明
- 大型存储设备
- 智能手机模块及消费电子

常见性能参数*

产品名称	RH-TSG-14
导热率 (瞬态法) W(m · K)	3.2 ± 0.2
最小界面厚度 (40psi) um	25
粘度, mPa.s	200000
颜色	蓝色
密度 g/m	3.2 ± 0.2
介电强度, KV/mm	≥11
体积电阻率 Ω · cm	≥1.0*10 ¹⁴
可操作时间 (25 ° C) d	28-30

使用说明

- 产品放置时间长后建议预先搅拌，然后再使用。
- 当需要应用于材料上时，使用前请小样确认，然后再应用。
- 使用前清洗待涂覆表面，除去污渍。
- 注意施工表面应该均匀一致，只要涂覆薄薄一层即可。
- 产品不宜长期暴露在空气中。

运输储存条件

- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存，最佳使用期限为 1 个月以内
- 可根据实际需求定制包装

产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。

其他注意事项

- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工, 再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触